

シリコンウェーハ用スラリー (Silicon Wafer Polishing Slurry)

厳しい技術革新の続くシリコンウェーハの製造に用いられる、一次研磨・二次研磨・仕上げ研磨用のスラリーです。高平滑性、低欠陥性、高生産性などの優れた研磨性能を安定して発揮いたします。

Nanopure slurry and NALCO slurry are designed for the first, second and final polishing of Silicon wafer manufactured for the silicon wafer industries which need technical innovation. They have a variety of grades to create better smoothness, lower defectivity and higher productivity.

Nanopure™ シリーズ (Nanopure™ Series)

Nanopure シリーズはシリコンウェーハの一次研磨・仕上げ研磨用のスラリーです。

Nanopure is designed for stock removal and final polishing of Silicon wafer.

特長 (Benefits)

- 高純度 (High purity)
- 高平滑性 (Smooth surface)
- 高生産性 (High productivity)
- 低欠陥性 (Low defectivity)

NALCO™ シリーズ (NALCO™ Series)

NALCO シリーズは、シリコンウェーハなど半導体結晶の研磨専用開発されたものです。高純度のコロイダルシリカゾルをベースとした高機能スラリーで、用途別に各種グレードがございます。

NALCO series are highly functional colloidal Silica polishing agents developed exclusively for the polishing of semiconductor substrate, such as Silicon wafers. NALCO slurry series are available in a variety of grades to meet individual applications.

※ Nanopure™ はニッタ・ハース社、NALCO™ は Nalco 社の商標です。

